

**【Causes/processes involved/keys to judgment】**

The defect is caused by the attachment of a body, wing or a leg of a small insect to a wet solder resist surface (Solder resist application)



【コメント】  
虫の羽根  
顕微鏡倍率 × 44

【注釋】  
幼虫的羽毛  
显微镜倍率 × 44

【Comments】  
A wing of insect  
Magnification: ×44

## 2-2-1-7 SR 金属異物卷込み／SR 卷入金属屑／A metallic foreign object in solder resist

【特徴】SRの中に銅、鉄、アルミなどの金属屑が巻き込まれている状態の欠陥

【特征】SR中卷入銅、鉄、鋁等的金属屑的缺陷。

【Characteristics】A metal debris, such as copper, iron and aluminum, is entrapped in solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】SR塗布中やSRインク混練中に金属屑が巻き込まれて出来たもの（SR混練工程、SR塗布工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR搅拌、涂布时卷入金属屑而引起的（SR搅拌、涂布工序）。

**【Causes/processes involved/keys to judgment】**

The defect is caused by the entrapment of a metal debris during solder resist ink mixing or solder resist application (Solder resist ink preparation or solder resist application)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×

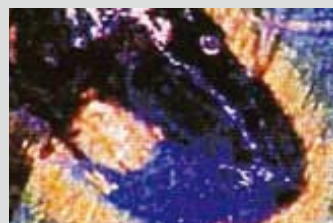
## 2-2-1-8 SR インク屑付着／附着 SR 油墨屑／Cured ink debris on solder resist

【特徴】SRの中や表面に固結したSRインク屑が巻き込まれている状態の欠陥

【特征】SR内部和表面卷入固化的SR油墨屑的缺陷。

【Characteristics】A solidified solder resist ink debris is entrapped in solder resist or on its surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR塗布中やSRインク混練中に固結したSRインク屑が巻き込まれて出来たもの（SR混練工程、SR塗布工程）



【コメント】  
虫の死骸  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
幼虫的尸骸  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
An insect body  
Magnification: ×